

Moduł zasilający w obudowie –"Half-size VI chips" nowy wyrób firmy Vicor



Seria modułów w obudowach typu –"VI chips" to produkty o wysokiej sprawności do tworzenia systemów zasilania o małych wymiarach zewnętrznych. Seria ta zawiera ponad **160 produktów** o wymiarach zbliżonych do 1/16 gabarytu „cegły” (brick). Najważniejszym argumentem do stosowania "VI chips" to wysoka sprawność, wysoka gęstość mocy, krótki czas reakcji, łatwość stosowania.

Firma Vicor **zrobiła następny krok do przodu w miniaturyzacji** wprowadzając półklockowy –"VI chips" czyli "half-size VI chips". Nowa obudowa ma wymiary 16,5x22x6,6 mm i jest to w przybliżeniu 1/32 "brick". Obecnie w standardzie tej obudowy są dostępne:

Moduły VTM (Voltage Transformation Modules) są dostępne w wariantach:

VIV0101THJ (k= 1/4: 26-55Vdc > 16,5-13,8Vdc)
VIV0102THJ (k=1/32: 26-55Vdc > 0,81-1,72Vdc)
VIV0103THJ (k=1/24: 26-55Vdc > 1,08-2,29Vdc)
VIV0104THJ (k=1/12: 26-55Vdc > 2,17-4,58Vdc)
VIV0105THJ (k=1/8: 26-48Vdc > 3,25-6,00Vdc)

Moduły BCM (Bus Converter Modules) są dostępne w wariantach :

VIB0101THJ (k= 1/4: 38-55Vdc > 9,5-13,75Vdc)

Najnowszy moduł serii "half-size VI chip" to **moduł VIB0101THJ** łatwy do integracji w systemach zasilających -IBA (Intermediate Bus Architecture) dla takich zastosowań jak technologia serwerów, ATF, telekomunikacja, przemysł – sterowanie.

Główne cechy - VIB0101THJ:

- Napięcie wejściowe: 38-55 Vdc
- Napięcie wyjściowe: 12 Vdc
- Moc wyjściowa max.: do 120W (max do 10A)
- Wymiary: 16,5x22x6,6 mm
- Współczynnik sprawności: 95%
- Gęstość mocy na cal objętości: 840W/in³
- Zabezpieczenie przed zaniżonym napięciem oraz za wysokim

Dokumentacja

Zapytaj o VIB0101THJ